

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2001-356313
(P2001-356313A)

(43)公開日 平成13年12月26日(2001.12.26)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード(参考)
G 0 2 F 1/13	1 0 1	G 0 2 F 1/13	1 0 1 2 H 0 8 8
B 0 5 C 1/02	1 0 4	B 0 5 C 1/02	1 0 4 2 H 0 8 9
5/00	1 0 1	5/00	1 0 1 4 D 0 7 5
9/06		9/06	4 F 0 4 0
B 0 5 D 5/06		B 0 5 D 5/06	F 4 F 0 4 1

審査請求 未請求 請求項の数55 O L (全 19 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2001-118140(P2001-118140)
(22)出願日 平成13年4月17日(2001.4.17)
(31)優先権主張番号 2000-21079
(32)優先日 平成12年4月20日(2000.4.20)
(33)優先権主張国 韓国(KR)

(71)出願人 390019839
三星電子株式会社
大韓民国京畿道水原市八達区梅灘洞416
(72)発明者 秋 大 鎭
大韓民国京畿道水原市八達区靈通洞ファン
ゴルマウル碧山アパート223棟1803号
(72)発明者 鄭 盛 旭
大韓民国京畿道龍仁市器興邑農書里山24番
地
(74)代理人 100094145
弁理士 小野 由己男 (外1名)

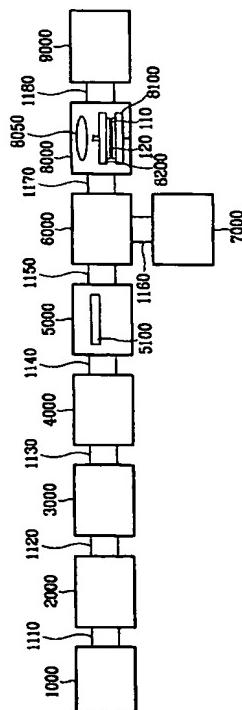
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 液晶表示装置用インラインシステム及びそれを構成する製造装置、液晶表示装置の製造方法

(57)【要約】

【課題】 液晶表示装置の製造方法を単純化して製造原価及び作業時間を減少させ、液晶表示装置の工程収率を向上させることにある。

【解決手段】 少なくとも2以上の液晶セル領域を有する元板の上下2つの基板の第1基板の上部にスペーサを散布するスペーサ噴射装置2000と、第1基板の上部に封印材を塗布する封印材塗布装置3000と、封印材が塗布されている第1基板の上部に液晶物質を塗布する液晶塗布装置5000と、真空状態で第1基板と第2基板とを結合して元板の液晶パネルを完成する基板結合装置8000とを含む液晶表示装置用インラインシステム。



【特許請求の範囲】

【請求項1】少なくとも一つ以上の液晶セル領域を有する元板の二つの基板のうちの一つの基板の上部にスペーサを散布するスペーサ噴射装置と、

前記二つの基板のうちの一つの基板の上部に封印材を塗布する封印材塗布装置と、

前記封印材が塗布されている前記基板の上部に液晶物質を塗布する液晶塗布機を含む液晶塗布装置と、

前記二つの基板を真空状態で前記二つの基板を結合して元板の液晶パネルを完成する基板結合装置と、を含む液晶表示装置用インラインシステム。

【請求項2】元板の前記二つの基板が各々積載されている第1及び第2基板積載装置と、

前記基板結合装置に前記二つの基板を提供するために前記二つの基板を装着する基板装着装置と、をさらに含む請求項1に記載の液晶表示装置用インラインシステム。

【請求項3】前記封印材と前記液晶物質との反応を防止するために前記封印材の表面に反応防止膜を形成するための封印材熱処理装置をさらに含む、請求項2に記載の液晶表示装置用インラインシステム。

【請求項4】前記第1基板積載装置、スペーサ噴射装置、封印材塗布装置、液晶塗布装置、基板装着装置及び基板結合装置は、インライン工程時間を単位として前記基板を移送する第1乃至第5インライン移送装置によって順に連結されていることを特徴とする、請求項3に記載の液晶表示装置用インラインシステム。

【請求項5】前記第2基板積載装置は第6インライン移送装置によって前記基板装着装置に連結されていることを特徴とする、請求項4に記載の液晶表示装置用インラインシステム。

【請求項6】前記第1基板積載装置、封印材塗布装置、液晶塗布装置、基板装着装置及び基板結合装置は、単位工程時間を単位として前記基板を移送する第1乃至第4インライン移送装置によって順に連結されていることを特徴とする、請求項3に記載の液晶表示装置用インラインシステム。

【請求項7】前記第2基板積載装置、スペーサ噴射装置及び基板装着装置は、第5及び第6インライン移送装置によって順に連結されていることを特徴とする、請求項6に記載の液晶表示装置用インラインシステム。

【請求項8】前記基板結合装置は、真空状態でインライン工程時間を単位として前記二つの基板を結合するために少なくとも二つ以上の真空チャンバを含むことを特徴とする、請求項1に記載の液晶表示装置用インラインシステム。

【請求項9】前記基板結合装置において多数の前記真空チャンバは、インライン工程時間を単位として多段階に前記真空状態を形成するために直列に連結されていることを特徴とする、請求項8に記載の液晶表示装置のインラインシステム。

10

【請求項10】前記基板結合装置において、前記真空状態でインライン工程時間を単位として前記二つの基板を提供するために多数の前記真空チャンバが並列に連結されていることを特徴とする、請求項8に記載の液晶表示装置用インラインシステム。

【請求項11】前記基板結合装置は、

前記二つの基板を支持し、前記二つの基板に圧力を加えるための第1及び第2圧縮プレートと、

前記封印材を硬化するための露光装置とを含むことを特徴とする、請求項1に記載の液晶表示装置用インラインシステム。

【請求項12】前記基板結合装置は、

前記二つの基板に圧力を加えるために前記二つの基板を支持し、前記二つの基板の間を真空に形成するために空気を排出することができる真空口を有する第1及び第2圧縮プレートと、

前記第1及び第2圧縮プレートの間の空間を密閉しながら真空を通じて前記第1及び第2圧縮プレートの間隔を調節することができる支持用チューブと、

前記封印材を硬化するための露光装置と、を含むことを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置用インラインシステム。

【請求項13】前記真空口は局部的に多数形成されており、多数の前記真空口は順次に空気を排出することを特徴とする、請求項12に記載の液晶表示装置用インラインシステム。

【請求項14】前記真空口は、前記第1及び第2圧縮プレートの辺部または角部に形成されていることを特徴とする、請求項13に記載の液晶表示装置用インラインシステム。

【請求項15】前記真空口は線型に形成されていることを特徴とする請求項13に記載の液晶表示装置用インラインシステム。

【請求項16】前記液晶塗布装置は、前記液晶セル領域に部分的に前記液晶物質を滴らすことができる注射器形態を有する液晶塗布機を含むことを特徴とする、請求項1に記載の液晶表示装置用インラインシステム。

【請求項17】前記液晶塗布装置は、前記液晶セル領域に全面的に前記液晶物質を散布することができるようになされた噴霧器形態を有する液晶塗布機を含むことを特徴とする、請求項1に記載の液晶表示装置用インラインシステム。

【請求項18】前記封印材塗布装置は、前記封印材を液晶注入口を有しないように閉曲線形態に形成することを特徴とする、請求項1に記載の液晶表示装置用インラインシステム。

【請求項19】前記封印材は、紫外線硬化材で形成することを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置用インラインシステム。

50 【請求項20】前記封印材は、前記二つの基板の結合工

程が終了した後にも前記液晶物質が充填されていないバッファー領域を有するように突出部を形成することを特徴とする、請求項1に記載の液晶表示装置用インラインシステム。

【請求項21】少なくとも一つ以上の液晶セル領域を有する元板の二つの基板のうちの一つの基板の上部の前記液晶セル領域に前記液晶物質を塗布する液晶塗布機を含む、液晶表示装置製造用液晶塗布装置。

【請求項22】前記液晶塗布機は、前記液晶セル領域に部分的に前記液晶物質を滴らすことができる注射器形態を有することを特徴とする、請求項21に記載の液晶表示装置製造用液晶塗布装置。

【請求項23】前記液晶塗布機は、前記液晶セル領域に全面的に前記液晶物質を散布することができるよう�数のノズルを有する噴霧器形態であることを特徴とする、請求項21に記載の液晶表示装置製造用液晶塗布装置。

【請求項24】少なくとも一つ以上の液晶セル領域を有する元板の二つの基板を真空状態で結合して液晶物質が注入されている元板の液晶パネルを完成する、液晶表示装置製造用基板結合装置。

【請求項25】前記二つの基板を支持し、前記二つの基板に圧力を加えるための第1及び第2圧縮プレートと、前記封印材を硬化するための露光装置と、を含むことを特徴とする請求項24に記載の液晶表示装置製造用基板結合装置。

【請求項26】前記二つの基板に圧力を加えるために前記二つの基板を支持し、前記二つの基板の間を真空に形成するために空気を排出することができる真空口を有する第1及び第2圧縮プレートと、前記第1及び第2圧縮プレートの間の空間を密閉しながら真空を通じて前記第1及び第2圧縮プレートの間隔を調節することができる支持用チューブと、前記封印材を硬化するための露光装置と、を含むことを特徴とする請求項24に記載の液晶表示装置製造用基板結合装置。

【請求項27】前記真空口は局部的に多数形成されており、多数の前記真空口は順次に空気を排出することを特徴とする、請求項26に記載の液晶表示装置製造用基板結合装置。

【請求項28】前記真空口は、前記第1及び第2圧縮プレートの辺部または角部に形成されていることを特徴とする、請求項27に記載の液晶表示装置製造用基板結合装置。

【請求項29】前記真空口は線型に形成されていることを特徴とする、請求項28に記載の液晶表示装置製造用基板結合装置。

【請求項30】真空状態でインライン工程時間を単位として前記二つの基板を結合するために少なくとも二つ以上の真空チャンバを含むことを特徴とする、請求項24

に記載の液晶表示装置製造用基板結合装置。

【請求項31】多数の前記真空チャンバは、インライン工程時間を単位として多段階に前記真空状態を形成するために直列に連結されていることを特徴とする、請求項30に記載の液晶表示装置製造用基板結合装置。

【請求項32】前記真空状態でインライン工程時間を単位として前記二つの基板を提供するために多数の前記真空チャンバは並列に連結されていることを特徴とする、請求項24に記載の液晶表示装置製造用基板結合装置。

10 【請求項33】少なくとも一つ以上の液晶セル領域を有する元板の二つの基板のうちの一つの基板の上部にスペーサを散布する第1段階と、

前記二つの基板のうちの一つの基板の上部に封印材を塗布する第2段階と、

前記封印材が塗布されている前記基板の上部に液晶物質を塗布する第3段階と、

真空状態で元板の液晶パネルを完成するために前記二つの基板を結合する第4段階と、を含む液晶表示装置の製造方法。

20 【請求項34】前記第2段階は、前記封印材と前記液晶物質との反応を防止するために1次硬化によって前記封印材の表面に反応防止膜を形成する第5段階をさらに含む、請求項33に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項35】前記第1段階、前記第2段階、前記第3段階、及び前記第4段階は、インライン工程で実施することを特徴とする、請求項34に記載の液晶表示装置の製造方法。

25 【請求項36】前記第1段階、前記第2段階及び前記第3段階は、一つの基板に対して実施することを特徴とする、請求項35に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項37】前記第1段階と、前記第2段階及び前記第3段階とは、互いに異なる基板に対して実施することを特徴とする、請求項36に記載の液晶表示装置の製造方法。

30 【請求項38】前記第4段階は、インライン工程時間を単位として多段階に真空状態を形成することを特徴とする、請求項33に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項39】前記第4段階は、真空状態でインライン工程時間を単位として前記二つの基板を提供することを特徴とする、請求項33に記載の液晶表示装置の製造方法。

40 【請求項40】前記第4段階は、
前記二つの基板を整列する第1工程と、
前記二つの基板に圧力を加えて前記封印材で前記二つの基板を結合させる第2工程と、
前記封印材を露光させて前記封印材を2次硬化する第3工程と、を含むことを特徴とする請求項33に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項41】前記第4段階は、
50 前記二つの基板を整列する第4工程と、

前記二つの基板の間を真空に形成する第5工程と、
真空を通じて前記二つの基板間の間隔を狭める第6工程
と、
前記二つの基板に圧力を加えて前記封印材で前記二つの
基板を結合させる第7工程と、
前記封印材を露光させて前記封印材を2次硬化する第8
工程と、を含むことを特徴とする請求項33に記載の液晶
表示装置の製造方法。

【請求項42】前記第5工程は、前記二つの基板が配置
される装置に局部的に形成されている真空口によって行
われることを特徴とする、請求項41に記載の液晶表示
装置の製造方法。

【請求項43】前記第5工程は、多数の前記真空口を通
じて順次に空気を排出させることを特徴とする、請求項
42に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項44】前記第3段階は、
前記液晶セル領域に部分的に前記液晶物質を滴らす第9
工程と、
前記基板を回転させる第10工程と、を含むことを特徴
とする請求項33に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項45】前記第3段階は、前記液晶セル領域に全
面的に前記液晶物質を散布することを特徴とする、請求
項33に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項46】前記第2段階では、前記封印材を液晶注
入口を有しないように閉曲線形態に形成することを特徴
とする、請求項33に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項47】前記封印材は紫外線硬化材で形成するこ
とを特徴とする、請求項33に記載の液晶表示装置の製
造方法。

【請求項48】前記封印材は、前記第4段階が終了した
後でも前記液晶物質が充填されていないバッファー領域
を有するように突出部を形成することを特徴とする請求
項33に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項49】少なくとも一つの基板には液晶物質、封
印材及びスペーサが形成されており、少なくとも一つ以
上の液晶セル領域を有する元板の二つの基板を真空状態
で結合して元板の液晶パネルを完成する段階を含む、液
晶表示装置の製造方法。

【請求項50】前記液晶パネル完成段階は、
前記二つの基板を整列する段階と、
前記二つの基板に圧力を加える段階と、
前記封印材で二つの基板を接着させる段階と、
前記封印材を硬化して前記二つの基板を結合する段階
と、を含むことを特徴とする請求項49に記載の液晶
表示装置の製造方法。

【請求項51】前記液晶パネル完成段階は、
前記二つの基板を整列する段階と、
前記二つの基板の間を真空に形成する段階と、
真空を利用して前記二つの基板の間隔を縮小させる段階
と、

10 **【請求項52】**前記真空形成段階は、前記二つの基板が
配置される装置に局部的に形成されている真空口を通じ
て行われることを特徴とする、請求項51に記載の液晶
表示装置の製造方法。

【請求項53】前記真空形成段階は、多数の前記真空口
を通じて順次に空気を排出させることを特徴とする、請求
項52に記載の液晶表示装置の製造方法。

【請求項54】前記液晶パネル完成段階は、インライン
工程時間を単位として多段階に真空状態を形成する段階
をさらに含むことを特徴とする、請求項50に記載の液晶
表示装置の製造方法。

【請求項55】前記液晶パネル完成段階は、真空状態で
インライン工程時間を単位として前記二つの基板を提供
することを特徴とする、請求項50に記載の液晶表示裝
置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置の製造
装置及びその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】一般に、液晶表示装置は電極が形成され
ている二つの基板及びその間に注入されている液晶物質
を含み、二つの基板は端部の周縁に印刷されて液晶物質
を封する封印材によって結合されており、二つの基板の
間に散布されている間隔材により支持されている。

【0003】このような液晶表示装置は二つの基板の間
に注入されており異方性誘電率を有する液晶物質に電極
を用いて電界を印加し、この電界の強さを調節して基板
を透過する光の量を調節することによって画像を表示す
る装置である。

【0004】液晶表示装置の製造方法では、まず、二つ
の基板に液晶物質の液晶分子を配向するための配向膜を
塗布して配向処理を実施した後、その中の一つの基板に
スペーサを散布し、液晶注入口を有する封印材を周縁に
40 印刷する。次に、二つの基板を整列した後にホットプレ
ス(hot press)工程によって二つの基板を付着し、液
晶注入口を通じて二つの基板の間に液晶物質を注入した
後、液晶注入口を封止して液晶セルを製作する。

【0005】近来の液晶表示装置の製造工程では生産性
向上のために1枚の主基板(motherglass:元板)から
なるパネル上に一つの液晶表示装置を形成するための副
基板(これを‘液晶セル’と称する)を多数形成し、液
晶物質を注入する前に切断工程によって元板のパネルを
4、6または8枚の液晶セルに分離した後、以後の工程
50 を液晶セル単位で進める。

【0006】しかし、このような液晶表示装置の製造方法において、液晶注入工程は真空状態で進めなければならないが、セル間隔を維持した状態で真空を形成したり狭い液晶注入口を通じて液晶を注入することに長時間を要するという短所がある。また、それぞれの単位工程ごとに所要時間が一定でなかったり液晶表示装置の駆動方式に応じて単位工程に要する時間が異なったり製造方法が元板単位の工程と液晶セル単位の工程とからなるため単位工程の各製造設備をインライン(in-line)または自動化工程として設計することが難しいので生産性を向上させることに限界がある。また、液晶注入時にスペーサが液晶物質の流れによって偏って配置される現象が発生するため均一なセル間隔を維持することが難しいという問題点がある。このような問題点は工程収率を低下させたり製造費用を上昇させる原因になる。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】本発明が達成しようとする技術的課題は、インラインまたは自動化工程が可能な液晶表示装置製造方法、そのための製造装置、これを含むインラインシステム及びこれを用いた液晶表示装置の製造方法を提供することにある。

【0008】本発明の他の技術的課題は、液晶表示装置の製造方法を単純化して製造原価及び作業時間を減少させることにある。本発明が達成しようとする他の技術的課題は液晶表示装置の工程収率を向上させることにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】このような本発明による液晶表示装置用インラインシステム及びこれを用いた液晶表示装置の製造方法では、多数の液晶セル領域を含む元板を分離しない状態で液晶物質が注入されている元板の液晶パネルを完成する。

【0010】まず、本発明による液晶表示装置の製造方法では、少なくとも一つ以上の液晶セル領域を有する元板の二つの基板のうちの一つの基板の上部にスペーサを散布する。その次に、二つの基板のうちの一つの基板の上部に封印材を塗布し、封印材が塗布されている基板の上部に液晶物質を塗布する。その後に、真空状態で元板の液晶パネルを完成するために二つの基板を結合する。

【0011】また第2段階は、封印材と液晶物質との反応を防止するために1次硬化によって封印材の表面に反応防止膜を形成する第5段階をさらに含むことができる。また、第1段階、第2段階、第3段階、及び第4段階は、インライン工程で実施することを特徴とすることができます。

【0012】また、第1段階、第2段階及び第3段階は、一つの基板に対して実施することを特徴とすることができます。また、第1段階と、第2段階及び第3段階とは、互いに異なる基板に対して実施することを特徴とす

ることができる。

【0013】また、第4段階は、インライン工程時間の単位として多段階に真空状態を形成することを特徴とすることができる。また、第4段階は、真空状態でインライン工程時間の単位として二つの基板を提供することを特徴とすることができる。

【0014】また、第4段階は、二つの基板を整列する第1工程と、二つの基板に圧力を加えて封印材で二つの基板を結合させる第2工程と、封印材を露光させて封印材を2次硬化する第3工程と、を含むことを特徴とすることができる。

【0015】また、第4段階は、二つの基板を整列する第4工程と、二つの基板の間を真空に形成する第5工程と、真空を通じて二つの基板間の間隔を狭める第6工程と、二つの基板に圧力を加えて封印材で二つの基板を結合させる第7工程と、封印材を露光させて封印材を2次硬化する第8工程と、を含むことを特徴とすることができる。

【0016】また、第5工程は、二つの基板が配置される装置に局部的に形成されている真空口によって行われることを特徴とすることができます。また、第5工程は、多数の前記真空口を通じて順次に空気を排出させることを特徴とすることができます。

【0017】また、第3段階は、液晶セル領域に部分的に液晶物質を滴らす第9工程と、基板を回転させる第10工程と、を含むことを特徴とすることができます。また、第3段階は、液晶セル領域に全面的に液晶物質を散布することを特徴とすることができます。

【0018】また、第2段階では、封印材を液晶注入口を有しないように閉曲線形態に形成することを特徴とすることができる。また、封印材は紫外線硬化材で形成することを特徴とすることができます。

【0019】また、封印材は、第4段階が終了した後でも液晶物質が充填されていないバッファー領域を有するように突出部を形成することを特徴とすることができます。また、液晶表示装置の製造方法は、少なくとも一つの基板には液晶物質、封印材及びスペーサが形成されており、少なくとも一つ以上の液晶セル領域を有する元板の二つの基板を真空状態で結合して元板の液晶パネルを完成する段階を含んでいる。また、液晶パネル完成段階は、二つの基板を整列する段階と、二つの基板に圧力を加える段階と、封印材で二つの基板を接着させる段階と、封印材を硬化して二つの基板を結合する段階とを含むことを特徴とすることができます。又は、液晶パネル完成段階は、二つの基板を整列する段階と、二つの基板の間を真空に形成する段階と、真空を利用して二つの基板の間隔を縮小させる段階と、二つの基板に圧力を加える段階と、封印材で二つの基板を接着させる段階と、封印材を硬化して二つの基板を結合する段階とを含むことを特徴とすることができます。

40
50

【0020】また、真空形成段階は、二つの基板が配置される装置に局部的に形成されている真空口を通じて行われることを特徴とすることができます。また、真空形成段階は、多数の前記真空口を通じて順次に空気を排出させることを特徴とすることができます。

【0021】また、液晶パネル完成段階は、インライン工程時間を単位として多段階に真空状態を形成する段階をさらに含むことを特徴とすることができます。また、液晶パネル完成段階は、真空状態でインライン工程時間を単位として二つの基板を提供することを特徴とすることができます。

【0022】上述した本発明の製造方法を具現するための液晶表示装置用インラインシステムは、少なくとも一つの液晶セル領域を有する元板の二つの基板のうちの一つの基板の上部にスペーサを散布するスペーサ噴射装置と、二つの基板のうちの一つの基板の上部に封印材を塗布する封印材塗布装置と、封印材が塗布されている基板の上部に液晶物質を塗布する液晶塗布機を含む液晶塗布装置と、真空状態で二つの基板を結合して元板の液晶パネルを完成する基板結合装置とを含む。

【0023】ここで、インラインシステムは元板の二つの基板が各々積載されている第1及び第2基板積載装置をさらに含むことができ、基板結合装置に二つの基板と共に提供するために二つの基板が装着されている基板装着装置をさらに含むことができる。また、封印材と液晶物質との反応を防止するために封印材の表面に反応防止膜を形成するための封印材熱処理装置をさらに含むことができる。

【0024】この時、第1基板積載装置、スペーサ噴射装置、封印材塗布装置、液晶塗布装置、基板装着装置及び基板結合装置はインライン工程時間を単位として基板を移送する第1乃至第5インライン移送装置によって順に連結されることができ、第2基板積載装置は第6インライン移送装置によって基板装着装置に連結されることができる。

【0025】また、他の実施例では、第1基板積載装置、封印材塗布装置、液晶塗布装置、基板装着装置及び基板結合装置は単位工程時間を単位として前記基板を移送する第1乃至第4インライン移送装置によって順に連結されることができ、第2基板積載装置、スペーサ噴射装置及び基板装着装置は第5及び第6インライン移送装置によって順に連結されることができる。

【0026】ここで、基板結合装置は真空状態でインライン工程時間を単位として二つの基板を結合するために少なくとも二つ以上の真空チャンバを含むのが好ましく、基板結合装置の多数の真空チャンバはインライン工程時間を単位として多段階に真空状態を形成するために直列に連結されることができ、基板結合装置で真空状態でインライン工程時間を単位として二つの基板を提供するために多数の真空チャンバは並列に連結されなければならない。

できる。

【0027】また、基板結合装置は二つの基板を支持し二つの基板に圧力を加えるための第1及び第2圧縮プレートと封印材を硬化するための露光装置とを含み、基板結合装置は二つの基板に圧力を加えるために二つの基板を支持しこの二つの基板の間に真空を形成するために空気を排出することができる真空口を有する第1及び第2圧縮プレートと、第1及び第2圧縮プレートの間の空間を密閉して真空によって第1及び第2圧縮プレートの間隔を調節することができる支持用チューブと、封印材を硬化するための露光装置とを含むことができる。

【0028】この時、真空口は局部的に多数形成されるのが好ましく、また多数の真空口は順次に空気を排出するのが好ましく、真空口は線状に形成されることができる。ここで、液晶塗布装置は液晶セル領域に部分的に液晶物質を滴らすことができる注射器形態を有することができ、液晶セル領域に全面的に液晶物質を散布することができるよう形成された噴霧器形態を有することもできる。

【0029】この時、封印材塗布装置は封印材を液晶注入入口を有しないように閉曲線形態に形成するのが好ましく、封印材は紫外線硬化材で形成するのが良く、また、封印材は二つの基板結合工程を終了した後に画面表示領域に液晶物質が全て充填され液晶物質が充填されていない余分の面積に対応するバッファー領域を有するように突出部を有するのが好ましい。また本発明に係る液晶表示装置製造用液晶塗布装置は、少なくとも一つ以上の液晶セル領域を有する元板の二つの基板のうちの一つの基板の上部の液晶セル領域に液晶物質を塗布する液晶塗布機を含んでいる。

【0030】また液晶塗布機は、液晶セル領域に部分的に液晶物質を滴らすことができる注射器形態を有することができ、又は、液晶セル領域に全面的に液晶物質を散布することができるよう多数のノズルを有する噴霧器形態であることもできる。

【0031】また、この液晶表示装置製造用基板結合装置は、少なくとも一つ以上の液晶セル領域を有する元板の二つの基板を真空状態で結合して液晶物質が注入されている元板の液晶パネルを完成することを特徴とすることができる。

【0032】また、この液晶表示装置製造用基板結合装置は、二つの基板を支持し、二つの基板に圧力を加えるための第1及び第2圧縮プレートと、封印材を硬化するための露光装置とを含むことを特徴とすることができる。

【0033】また、この液晶表示装置製造用基板結合装置は、前記二つの基板に圧力を加えるために前記二つの基板を支持し、前記二つの基板の間を真空に形成するために空気を排出することができる真空口を有する第1及び第2圧縮プレートと、第1及び第2圧縮プレートの間

の空間を密閉しながら真空を通じて第1及び第2圧縮プレートの間隔を調節することができる支持用チューブと、封印材を硬化するための露光装置と、を含むことを特徴とすることができる。

【0034】また、真空口は局部的に多数形成されており、多数の前記真空口は順次に空気を排出することを特徴とすることができます。また真空口は、第1及び第2圧縮プレートの辺部または角部に形成されていることを特徴とすることができます。また、真空口は、線型に形成されていることを特徴とすることができます。

【0035】また、この液晶表示装置製造用基板結合装置は、真空状態でインライン工程時間を単位として二つの基板を結合するために少なくとも二つ以上の真空チャンバを含むことを特徴とすることができます。また、液晶表示装置製造用基板結合装置では、多数の前記真空チャンバは、インライン工程時間を単位として多段階に前記真空状態を形成するために直列に連結されていることを特徴とすることができます。

【0036】また、この液晶表示装置製造用基板結合装置は、真空状態でインライン工程時間を単位として二つの基板を提供するために、多数の前記真空チャンバは並列に連結されていることを特徴とすることができます。

【0037】

【発明の実施の形態】以下、添付した図面を参照して、本発明の実施例による液晶表示装置の製造方法、そのための製造装置、これを含むインラインシステム及びこれを利用した液晶表示装置の製造方法について本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に実施することができるように詳細に説明する。

【0038】まず、本発明の実施例によるインラインシステムを用いて完成した液晶表示装置用液晶パネルについて説明する。図1は本発明の実施例によるインラインシステムを用いて完成した液晶表示装置用液晶パネルの構造を示した平面図であり、図2は図1のII-II'線に沿って切断した断面図である。

【0039】図1及び図2に示したように、本発明の実施例による液晶表示装置の製造方法で液晶注入工程及び基板結合工程を終了した一つの元板からなる液晶パネル100は同時に多数の液晶表示装置用液晶セルを有する。例えば、図1のように、互いに対向する絶縁基板110、120と二つの基板110、120の間に注入されている液晶物質層130とを含む液晶パネル100には4個の液晶セル領域111、121、131、141が形成される。液晶物質層130と混合されている球形のスペーサ140は二つの基板110、120を平行に支持し、注入された液晶物質層130は二つの基板110、120の端部に形成されている液晶セルの単位に形成されている封印材150によって封止されている。この時、二つの基板110、120を平行に支持するために封印材150にスペーサを含ませることもできる。

【0040】このような本発明の実施例による液晶表示装置の製造方法では、液晶パネル100は液晶セルの単位に分離されていない状態で液晶物質層130が注入されていて、図面符号a及びbは液晶注入工程及び基板結合工程が終了した後に液晶パネルをセル単位に分離するための切断線を示したものである。

【0041】このような液晶パネル100の基板110、120には互いに交差して画素領域を定義し走査信号または映像信号のような電気的な信号を伝達するための多数の配線、映像信号を制御するためのスイッチング素子である薄膜トランジスタ、液晶分子を駆動するために電気場を形成する画素電極及び共通電極、または画像を表示するのに要求される赤、緑、青のカラーフィルターを含むことができる。

【0042】図3は本発明の実施例による液晶表示装置を製造するためのインラインシステムを示す構成図であり、図4a及び図4bは本発明の実施例による液晶表示装置の製造方法でのスペーサを示した図面であり、図5a及び図5bは本発明の実施例による液晶表示装置の製造方法での封印材の形態を示した平面図であり、図6a乃至図6cは本発明の実施例による製造方法での封印材を硬化する順序を順次に示した断面図であり、図7a及び図7bは本発明の実施例による液晶表示装置の製造方法での液晶物質を塗布する工程を示した図面であり、図8a乃至9bは本発明の実施例による液晶表示装置での圧力プレートに基板を吸着させる方法を示した図面である。

【0043】図3に示すように、本発明の実施例による液晶表示装置を製造するためのインラインシステムは、元板からなる液晶パネルの二つの基板110、120のうちの一つの基板が分類されて積載されている第1基板積載装置1000と、スペーサ(spacer)噴射装置200と、封印材塗布装置3000と、封印材熱処理装置4000と、液晶塗布機5100を含む液晶塗布装置5000と、基板装着装置6000と、第2基板積載装置7000と、露光装置8050を含む基板結合装置800とアンロード(unload)装置9000とを含む。この時、第1基板積載装置1000、スペーサ噴射装置2000、封印材塗布装置3000、封印材熱処理装置4000、液晶塗布装置5000、基板装着装置6000、基板結合装置8000及びアンロード装置9000はインライン工程時間を単位として基板110、120を移送することができるインライン移送装置1110、1120、1130、1140、1150、1170、1180によって順に連結されており、第2基板積載装置7000はインライン移送装置1160によって基板装着装置6000に連結されている。この時、基板結合装置8000で二つの基板110、120を結合する工程は真空中で行われるので、インライン移送装置1170、1180は真空チャンバ(chamber)用連結手段を

含むことができる。

【0044】このような、本発明の実施例による液晶表示装置を製造するためのインラインシステムを利用した液晶表示装置の製造方法を説明する。まず、元板からなる液晶パネル100の一つの基板110が分類されて積載されている第1基板積載装置1000からインライン移送装置1110を用いてスペーサ(spacer)散布装置2000に基板110を移送した後、基板110の上部に二つの基板110、120の間隔を維持するためのスペーサ140を所望の密度に散布する。この時、スペーサ140は形成させようとする液晶パネル100の間隔より10%～30%程度大きな直径を有し、球形または円筒形の形態を有するのが好ましい。この時、スペーサ140を単純に散布のみをする場合には、製造工程時に発生する外部の衝撃や液晶物質の流れによってスペーサ140が部分的に偏って配置されるようになって、完成した液晶パネルの二つの基板110、120間隔が不均一に形成されることがある。このような問題点を防止するために、スペーサ140は基板110に付着されるのが好ましく、このために図4aのようにエポキシ(epoxy)系列の高分子(polymer)からなる接着剤142がコーティングされたスペーサ140を基板110の上部に散布した後、図4bのように紫外線を照射して接着剤142が基板110の上部に流れるようにして基板110にスペース140の位置を固定させることができる。また、写真工程によって基板110にスペーサ140を形成することもできる。この時、封印材150に混合されているスペーサも共に形成することができ、スペーサ140を散布する工程の代わりに写真工程によってスペーサを形成することができ、このような方法は大型基板でも均一に形成することができるという長所を有している。

【0045】次いで、移送装置であるインライン移送装置1120を用いてスペーサ140が散布された基板110を封印材塗布装置3000に移送した後、基板110の上部に封印材150を塗布する。この時、封印材150は従来の技術と異なり液晶注入口を有しないように閉曲線形態に形成し、熱硬化材または紫外線硬化材で形成することができ、二つの基板110、120の間隔を支持するためのスペーサを含むこともできる。前述のように、本発明の実施例の製造方法では液晶注入口を形成しないため正確な量に調節するのが難しく、液晶物質の量が多い場合には封印材150が損傷することがあり、液晶物質の量が少ない場合には液晶物質が充填されない部分が生じることがある。このような問題点を解決するために本発明では封印材150に突出部を有するように多様な模様に形成することによって基板結合工程が終了しても液晶物質が画面表示領域に全て充填され余分の面積を有するバッファー領域が形成されるようにするのが好ましい。図5aのような場合には、以後の二つの基板

110、120の結合工程時、実際領域(c、画面表示領域)に充填される量より多くの液晶物質が塗布される場合に余分の液晶物質が流れ出しができるように基板110に形成されている封印材150は少なくとも一辺にバッファー領域151を有する。図5bのような場合には余分の液晶物質が流れ出しができるように実際領域(c)の外の周囲にバッファー領域152を有するように封印材150が波形模様に形成されたり屈曲形成されている。ここで、実際領域cは基板結合工程時に液晶が充填される領域を意味する。この時、以後の液晶塗布工程で塗布される液晶物質の量は基板結合工程での実際領域(c)に充填される量よりは多く封印材150によって定義される体積よりは少ないので好ましい。

【0046】次いで、基板110をインライン移送装置1130を用いて封印材熱処理装置4000に移送した後、液晶物質層130と封印材150とが反応しないよう露光工程または熱処理工程によって封印材150の表面に反応防止膜を形成するのが好ましい。このために封印材150には紫外線硬化材を使用するのが好ましく、熱または紫外線を用いることができる。1次硬化時、封印材150は図6aに示されているように表面の反応防止膜として硬化された部分155と硬化されない部分157とに分離される。以後の二つの基板110、120の結合工程時、初期には図6bのように封印材150の表面の反応防止膜155が圧力によって押さえられることにより二つの基板110、120が接着され、図6cのように2次硬化工程で紫外線を照射して封印材150を完全に硬化させることにより二つの基板110、120を結合する。

【0047】次いで、基板110をインライン移送装置1140を用いて液晶塗布装置5000に移送した後、液晶塗布機5100を用いて液晶セル領域111、121、131、141の大きさに応じて液晶物質層130を形成することができるよう所定の量だけ液晶物質を塗布する。この時、液晶塗布機5100は、図7aに示されているように、基板110の液晶セル領域111、121、131、141各々に部分的に液晶物質132を滴らすことができる注射器形態を有することができ、図7bに示されているように、液晶セル領域111、121、131、141に全面的に液晶物質132を散布することができ、ジグ5110及びジグ5110に連結されているノズル(nozzle)5120を含む噴霧器形態を有することができる。前者の方法は元板の液晶パネル100を一つの液晶セルとして製造する場合に有利で、このような場合には基板110を回転させて液晶塗布時間を最小化するのが好ましく、回転速度は30～60rpm程度とする。後者の方法はノズル5120の個数及び散布の幅(d)を調節することによって多様な液晶セルの大きさに対応することができる。従来の技術では液晶注入口を用いて液晶セルを単位にして真空を形成した

状態で液晶物質を注入したが、本発明では液晶物質を回転塗布または散布する方法を使用することによって製造工程時間を減少させることができる。また、従来の技術では液晶セルの大きさまたは駆動方式による液晶物質の他の特性によって液晶注入時間が一定でないため単位工程時間を一定に調節することができなかった。しかし、本発明では液晶物質を塗布または散布する方法を使用することによって液晶セルの大きさまたは液晶物質の特性に拘らず該当する単位工程時間を一定に調節することができる。

【0048】次いで、液晶物質が塗布されている基板110をインライン移送装置1150を用いて基板装着装置6000に移送する。この時、インライン移送装置1160を用いて、第2基板積載装置7000に積載されている基板120も共に基板装着装置6000に移送する。

【0049】次いで、インライン移送装置1170を用いて真空チャンバからなる基板結合装置8000に二つの基板110、120を移送し、真空状態で二つの基板110、120を結合して元板の液晶パネル100を完成する。図面に示されているように、基板結合装置8000で二つの基板110、120は各々第1及び第2圧縮プレート8100、8200に接着されて平行に整列する。次いで、第1及び第2圧縮プレート8100、8200を均一な力で圧力を加えて二つの基板110、120を圧着させながら二つの基板110、120を整列する。このように、圧力を加えると、基板110に散布されているスペーサ140（図2参照）または封印材150（図2参照）のスペーサは圧縮力を受け、この圧縮力によって変形されることがある。この時、基板110に散布されている液晶物質は液晶セル領域111、121、131、141（図1参照）全般にわたって拡散されて液晶物質層130（図2参照）が形成される。次いで、所望のセルのギャップで二つの基板110、120の間隔を合せた後、露光装置8050を用いて紫外線を照射して図6cのように2次硬化によって封印材を完全に硬化させて二つの基板110、120を結合させる。二つの基板110、120を密着させたり2次硬化を実施する工程中にも二つの基板110、120は微細に整列させるのが好ましく、二つの基板110、120に加えられた圧力を均一にするためには空気加圧式を利用して圧力を加えるのが好ましい。この時、基板110、120を第1及び第2圧縮プレート8100、8200に固定させる方法には点（point）真空吸着方法または平面（planar）真空吸着方法があり、図8a乃至図9bを参照して具体的に説明する。

【0050】まず、点真空吸着方法は、図8a及び図8cに示されているように、基板110、120の角部四部分に第1及び第2圧縮プレート8100、8200に付着されている棒型パイプ8110を各々密着させパイ

プ8110の内部8111を真空状態に形成して基板110、120を第1及び第2圧縮プレート8100、8200に固定させる。この時、基板110、120の中央部112、122が図8bのように曲がる場合には二つの基板110、120を正確に整列して結合させることができない。このような問題点を解決するために、図8cに示されているように、ポンピング（pumping）によって基板110、120と支持台8100との間の空間を真空状態に形成して基板110、120を平らにするのが好ましい。

【0051】また、平面真空吸着方法は、図9a及び図9bに示されているように、基板110、120を第1及び第2圧縮プレート8100、8200に付着されている平面形パイプ8220を密着させパイプ8220に形成されている線状の真空口8221を真空状態に形成して基板110、120を第1及び第2圧縮プレート8100、8200に固定させる。後者の場合には前者の場合より基板110、120と第1及び第2圧縮プレート8100、8200とが接する部分を全面的に真空化することによって支持度を均一にすることができ、基板110、120の大きさに影響を受けず、基板110、120が曲がることを防止して二つの基板110、120をより精密に結合することができる。

【0052】次いで、完成した液晶パネル100（図1参照）を真空チャンバ用連結装置1180を用いてアンロード装置9000に移送した後、切断装置に移送して液晶セル領域111、121、131、141に液晶パネル100を分離して液晶表示装置用液晶セルに分離する。

【0053】このような本発明の実施例による製造方法で二つの基板110、120を結合するためには真空を形成しなければならないので、スペーサ140を散布したり、封印材150または液晶物質を塗布したりまた二つの基板110、120を結合する単位工程時間に比べて真空状態を形成する時間が多くかかる。この時、最も遅い単位工程は以後の単位工程時間も遅延されて生産性を低下させ、このような問題点を解決するためには多数の真空チャンバを利用する方法があり、真空を形成する空間を最小化する方法がある。これについて図面を参照して本発明の実施例によるインラインシステムでの基板結合装置の構造について具体的に説明する。

【0054】まず、多数のチャンバを利用する方法について説明する。図10乃至図12は本発明の実施例によるインラインシステムでの基板結合装置の構造について具体的に示した構成図である。

【0055】まず、図10に示されているように、本発明の一実施例による基板結合装置8000は第1乃至第4真空チャンバ8300、8400、8500、8600とこれらを直列に連結する真空チャンバ用連結装置85010、8020、8030とを含み、真空チャンバ用

連結装置8040によって第4真空チャンバ8600に連結されている基板結合用真空チャンバ8700を含む。このような構成によって二つの基板110、120を第1乃至第4真空チャンバ8300、8400、8500、8600に単位工程時間の間に順次に移送して所望の真空を形成した状態で、二つの基板110、120を基板結合用真空チャンバ8700に移送して前述の方法で二つの基板110、120を整列して結合する。このようにすると、真空を単位工程時間に合せて多段階に形成することができるのでインライン工程時間を単位にして液晶パネルを生産して生産性を向上させることができ、単位工程時間を基準にして進行するインライン工程を設計することができる。

【0056】本発明の他の実施例による基板結合装置3000は、図11に示されているように、前述の実施例と同一に第1乃至第4真空チャンバ8300、8400、8500、8600と基板結合用真空チャンバ8700とを含む。

【0057】しかし、第1乃至第4真空チャンバ8300、8400、8500、8600各々は真空チャンバ用連結装置1171、172、1173、1174によって基板装着装置6000に連結されており、真空チャンバ用連結装置1191、1192、1193、1194によって基板結合用真空チャンバ8700に並列に連結されている。このような構成では、二つの基板110、120を第1乃至第4真空チャンバ8300、8400、8500、8600に順次に移送して所望の真空を形成する。次いで、真空状態で第1乃至第4真空チャンバ8300、8400、8500、8600から順次に二つの基板110、120を取り出して基板結合用真空チャンバ8700にインライン単位工程時間に合せて移送する。このように第1乃至第4真空チャンバ8300、8400、8500、8600を並列に連結する場合には所望の真空を形成する時間が遅延されても基板結合用真空チャンバ8700にはインライン単位工程時間に合せて基板110、120を提供することができるのでインライン単位工程時間で液晶パネルを生産して生産性を向上させることができ、単位工程時間を基準に進行するインライン工程を設計することができる。

【0058】図10及び図11では真空チャンバが四つである場合を例としてあげたが、単位工程時間と真空を形成する時間との比によって真空チャンバの数は異なるように決定されることがある。

【0059】以下、真空を形成する空間を最小化する方法について説明する。図12に示されているように、本発明の実施例による基板結合装置は、図8a及び8bのように、二つの基板110、120が各々真空で吸着されており、少なくとも一つの真空口8900を有する第1及び第2圧縮プレート8100、8200と、第1及び第2圧縮プレート8100、8200の間の空間を密

閉しながら真空を通じて間隔を調節できる支持用チューブ8800とを含む。このような構成ではまず、二つの基板110、120を各々第1及び第2圧縮プレート8100、8200の内側面に真空を通じて吸着させる。次いで、真空口8900を通じて第1及び第2圧縮プレート8100、8200の間の空気を排出して二つの基板110、120の間を0.1 Torr以下の真空を維持するようとする。次いで、支持用チューブ8800内部の空気を徐々に排出させて第1及び第2圧縮プレート8100、8200の間の間隔を縮小させて二つの基板110、120を接触させ、外部から圧力を印加して所望のセル間隔を維持し、紫外線を照射して封印材150を硬化して元板の液晶パネル100(図1参照)を完成する。

【0060】ここで、待機状態で真空口8900を通じて空気を排出させることで真空に形成する時、液晶物質132が基板110の端部に偏る場合には二つの基板110、120の間隔が不均一な状態で液晶パネルが完成する場合がある。このような問題点を解決するために第21及び第2圧縮プレート8100、8200に部分的に真空口8900を形成し、順次に空気を排出させて真空を形成するのが好ましい。図13aは真空口8900を第1及び第2圧縮プレート8100、8200の角部に形成した場合であり、図13bは真空口8900を第1及び第2圧縮プレート8100、8200の辺部に形成した場合であり、図13cは真空口8900を第1及び第2圧縮プレート8100、8200の縁部周囲に形成した場合である。また、図13dは真空口8900を第1及び第2圧縮プレート8100、8200の辺部に線状に形成した場合であり、図13eは真空口8900を第1及び第2圧縮プレート8100、8200の角部に線状に形成した場合であり、図13fは真空口8900を第1及び第2圧縮プレート8100、8200の縁部周囲に一定の間隔をおいて線状に形成した場合である。ここで、真空を形成するために真空口8900を用いて空気を排出させる時に液晶物質132の粘性を考慮して多数の真空口8900を順次に用いるのが好ましく、このような模様の真空口8900は二つの第1及び第2圧縮プレート8100、8200の両方に形成することができ、第1及び第2圧縮プレート8100、8200のいずれか一方にのみ選択的に形成することもできる。

【0061】図3を参照して前述した本発明の実施例による液晶表示装置用インラインシステム及びこれを利用した液晶表示装置の製造方法では二つの基板110、120のうちの一つの基板にスペーサを散布し、封印材を形成し、液晶物質を塗布したが、一つの基板にはスペーサのみを散布し、他の基板には封印材を形成して液晶物質を塗布することができる。このような場合、図3においてスペーサ噴射装置2000は第2基板積載装置7000と基板装着装置6000との間にインライン移送裝

置を通じて連結されることができる。

【0062】また、図3を参照して前述した本発明の実施例による液晶表示装置用インラインシステムでは、基板結合用真空チャンバを含む基板結合装置8000を一つのみ設計したが、基板結合装置を多数形成することができ、これについて図面を参照して説明する。

【0063】図14は本発明の他の実施例による多数の基板結合装置を有する液晶表示装置用インラインシステムを概略的に示した構成図である。図14のように、本発明の他の実施例による液晶表示装置用インラインシステムは封印材150(図12参照)及び液晶物質132が塗布されている第1基板110とスペーサ140が散布されている第2基板120とが装着されている基板装着装置6100、多数の基板結合装置8001、8002、8003を含む。図面に示されているように、基板装着装置6100では第1基板110と第2基板120とを多数の基板結合装置8001、8002、8003に各々提供することができ、多数の基板結合装置8001、8002、8003は二つの基板110、120を結合して順次に生産することができる。このように、多数の基板結合装置8001、8002、8003を構成する場合にはインラインシステムを工場自動化に応用するものが有利で、ある一つの基板結合装置に欠陥が発生してもインラインシステムで液晶パネルを生産することができ、追加される設備費用に対して生産量を増加させることができる。

【0064】

【発明の効果】以上で説明したように、本発明によるところ、液晶表示装置の製造工程を単純化することによって原価及び作業時間を節減することができ、工程収率を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例によるインラインシステムを用いて完成した液晶表示装置用液晶パネルの構造を示した平面図。

【図2】図1のII-II'線に沿って切断した断面図。

【図3】本発明の実施例による液晶表示装置を製造するためのインラインシステムを示す構成図。

【図4a】スペーサを示した図面(その1)。

【図4b】スペーサを示した図面(その2)。

【図5a】封印材の形態を示した平面図(その1)。

【図5b】封印材の形態を示した平面図(その2)。

【図6a】封印材を硬化する順序を順次に示した断面図(その1)。

【図6b】封印材を硬化する順序を順次に示した断面図(その2)。

【図7a】液晶物質を塗布する工程を示した図面(その1)。

【図7b】液晶物質を塗布する工程を示した図面(その2)。

【図8a】圧力プレートに基板を吸着する方法を示した図面(その1)。

【図8b】圧力プレートに基板を吸着する方法を示した図面(その2)。

【図8c】圧力プレートに基板を吸着する方法を示した図面(その3)。

【図10】基板結合装置の構造について具体的に示した構成図(その1)。

【図11】基板結合装置の構造について具体的に示した構成図(その2)。

【図12】基板結合装置の構造について具体的に示した構成図(その3)。

【図13a】基板結合装置の圧縮プレートの構造を示した平面図。

【図13b】基板結合装置の圧縮プレートの構造を示した平面図。

【図13c】基板結合装置の圧縮プレートの構造を示した平面図。

【図13d】基板結合装置の圧縮プレートの構造を示した平面図。

【図13e】基板結合装置の圧縮プレートの構造を示した平面図。

【図13f】基板結合装置の圧縮プレートの構造を示した平面図。

【図14】本発明の他の実施例による多数の基板結合装置を有する液晶表示装置用インラインシステムを示した構成図。

【符号の説明】

100 液晶パネル

30 110、120 絶縁基板

111、121、131、141 液晶セル領域

112、122 基板の中央部

130 液晶物質層

132 液晶物質

140 スペーサ

142 接着剤

150 封印材

1000 第1基板積載装置

2000 スペーサ噴射装置

40 3000 封印材塗布装置

4000 封印材熱処理装置

5000 液晶塗布装置

5100 液晶塗布機

6000 基板装着装置

7000 第2基板積載装置

8000 基板結合装置

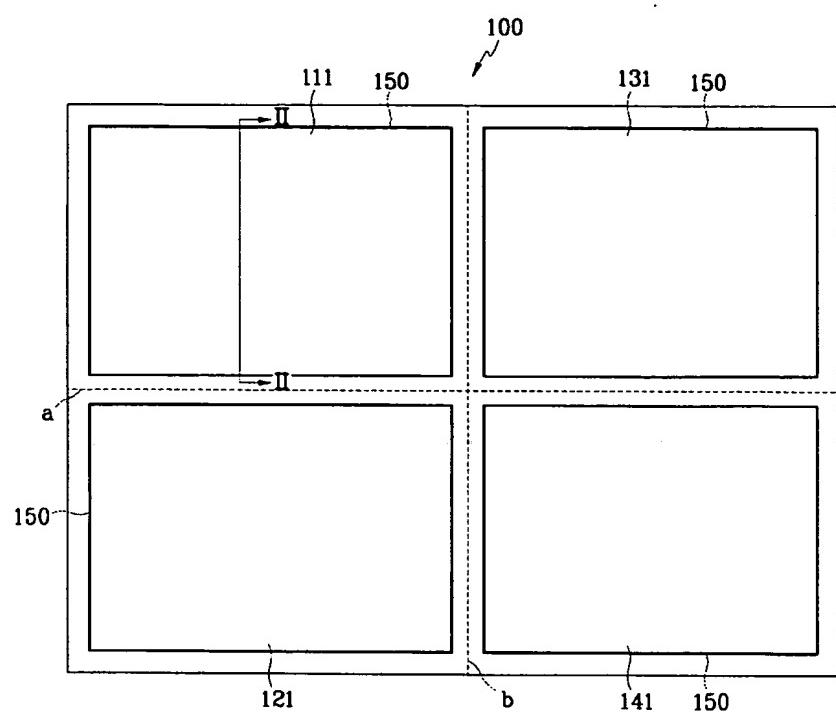
8050 露光装置

9000 アンロード装置

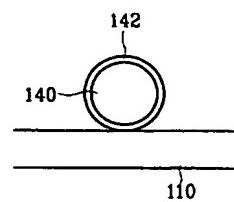
1110、1120、1130、1140、1150、

50 1170、1180 インライン移送装置

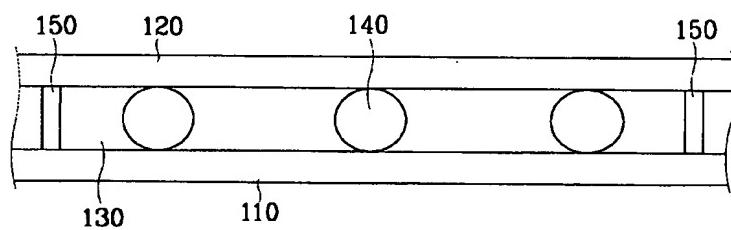
【図1】



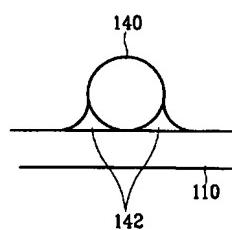
【図4 a】



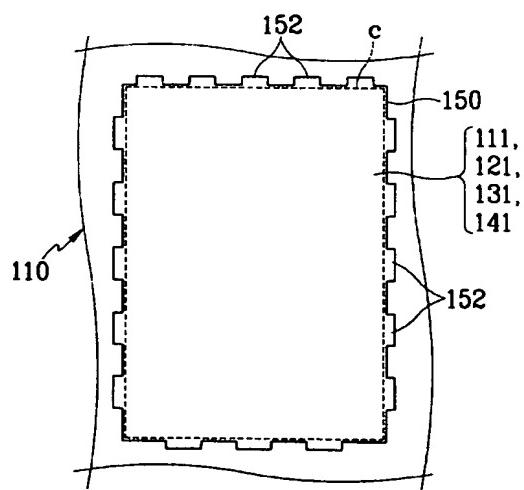
【図2】



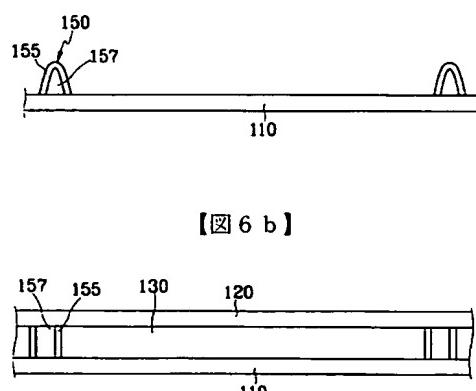
【図4 b】



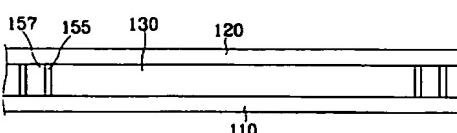
【図5 b】



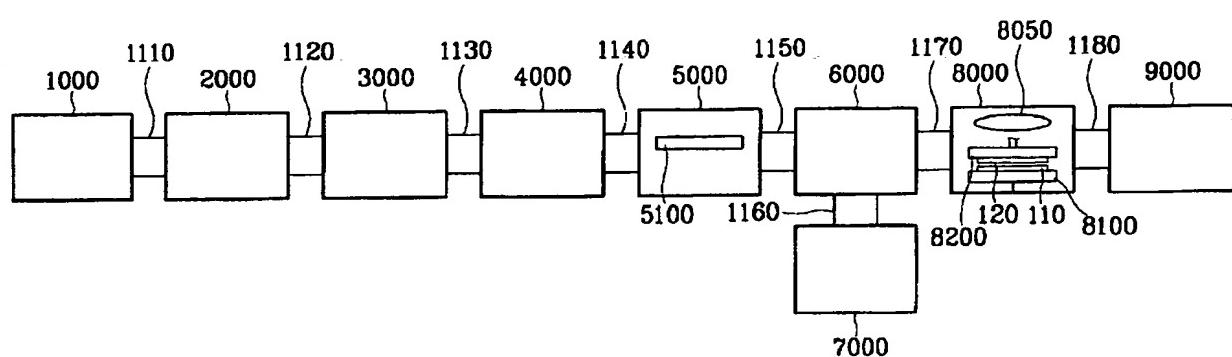
【図6 a】



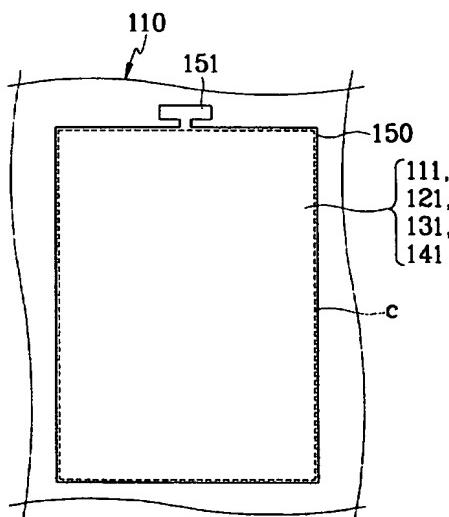
【図6 b】



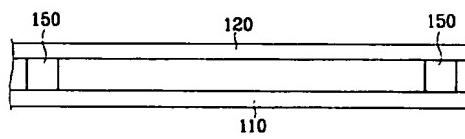
【図3】



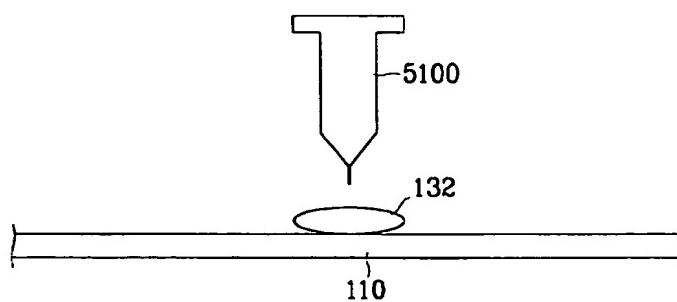
【図5 a】



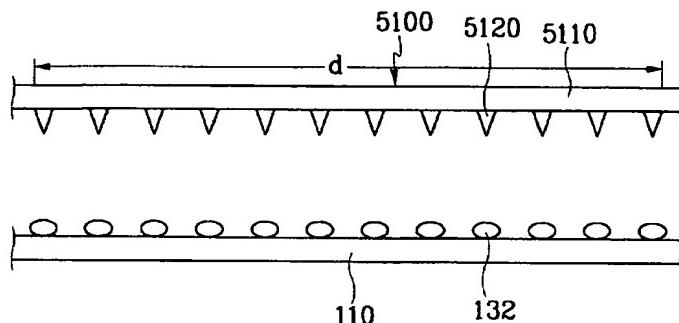
【図6 c】



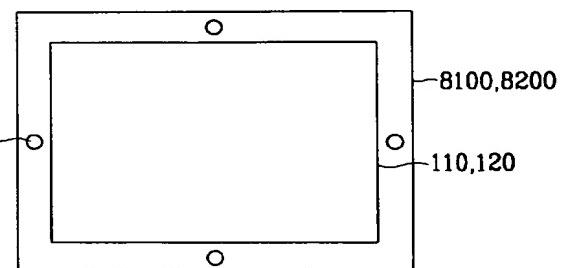
【図7 a】



【図7 b】

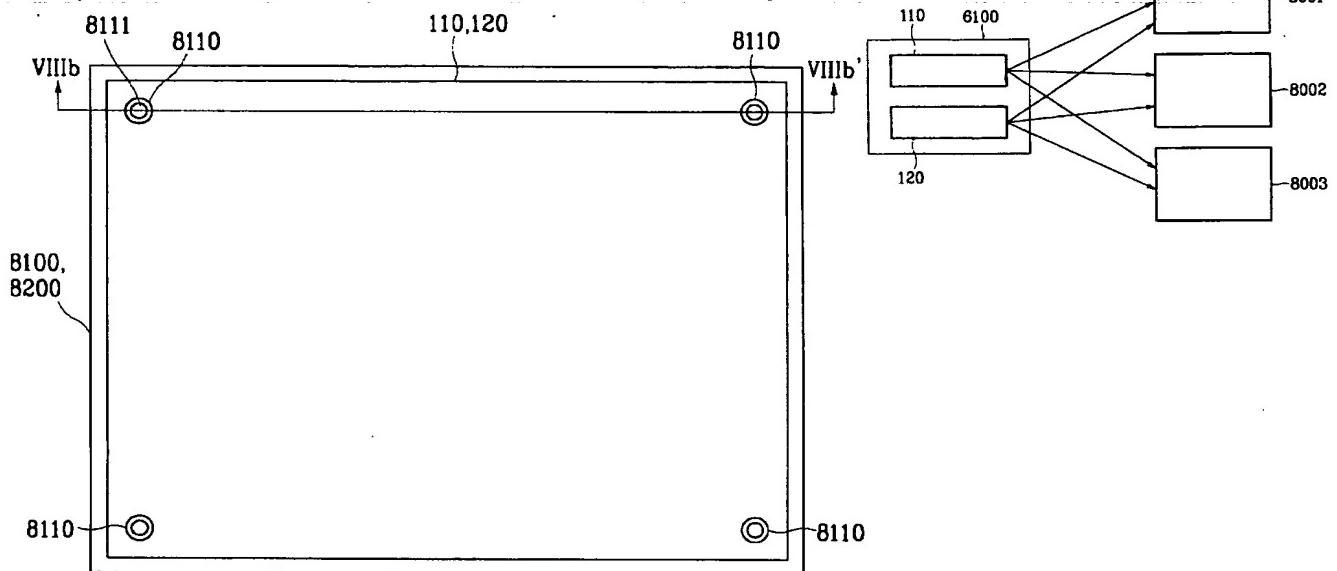


【図13 b】

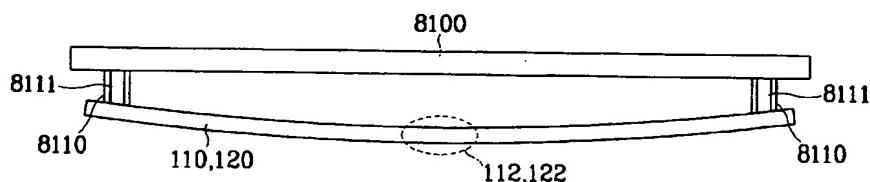


【図14】

【図8 a】

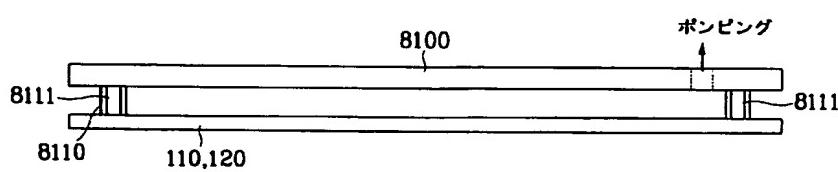


【図8 b】

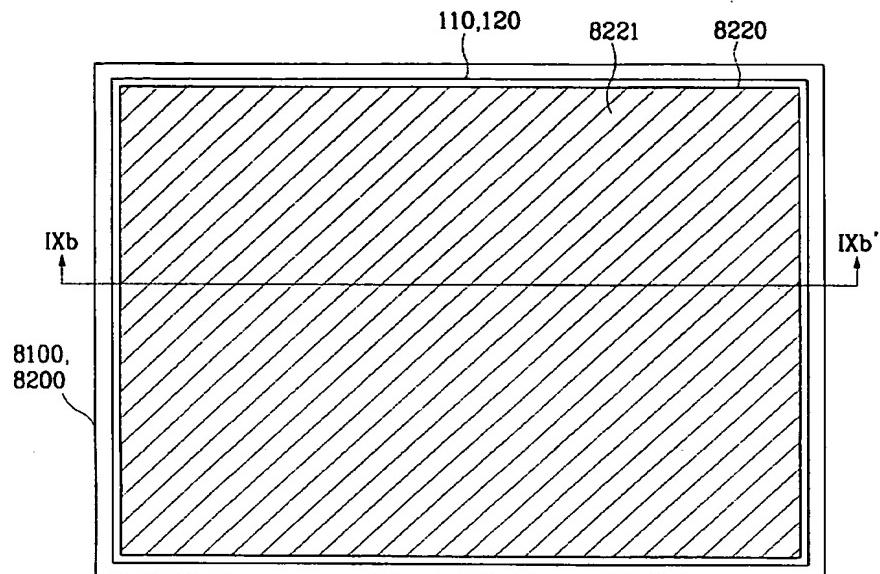


【図8 c】

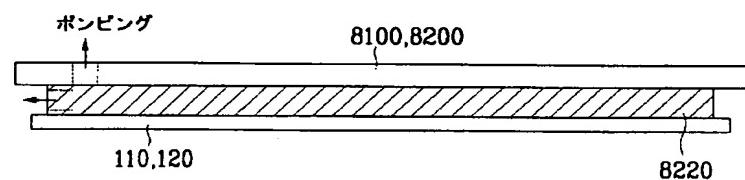
FIG. 8C



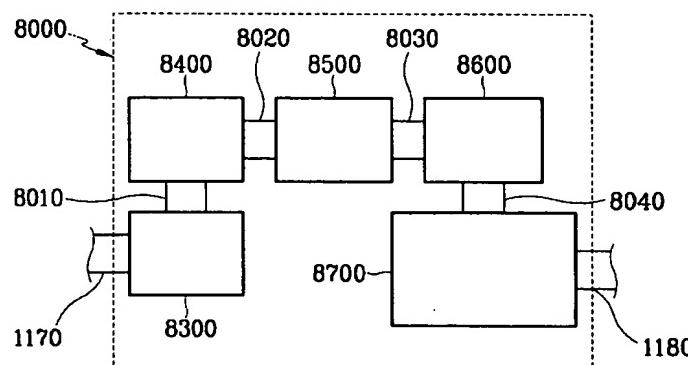
【図9a】



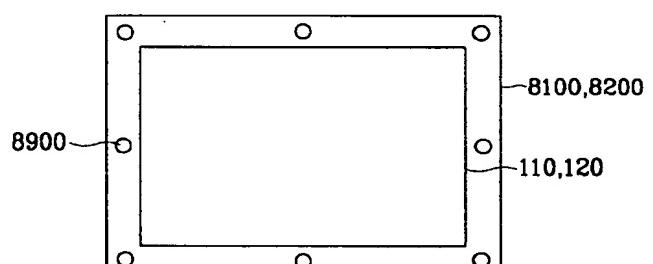
【図9b】



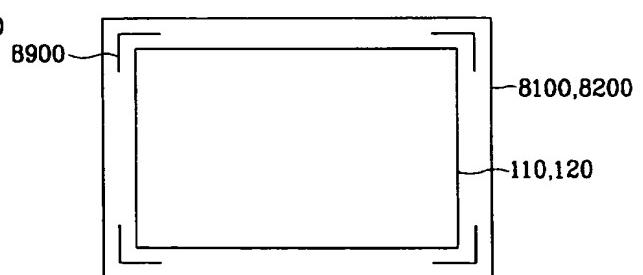
【図10】



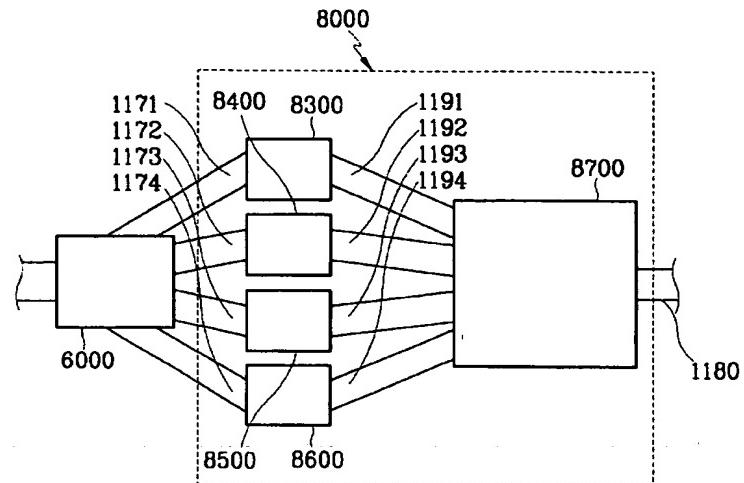
【図13c】



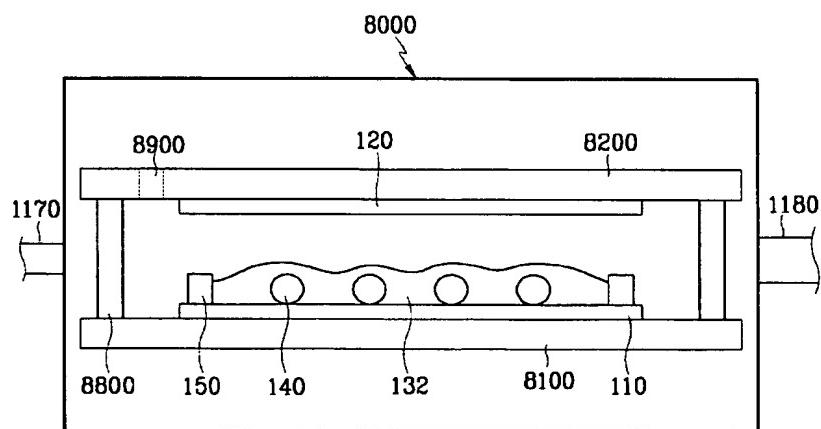
【図13e】



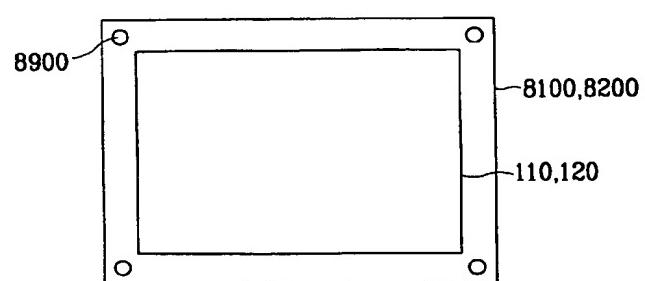
【図11】



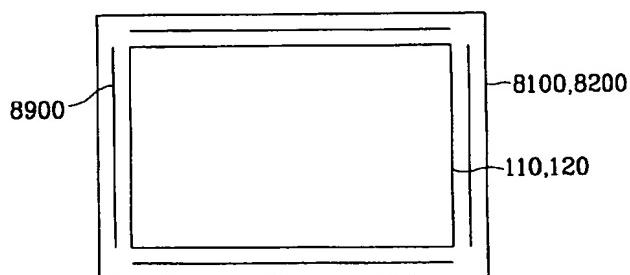
【図12】



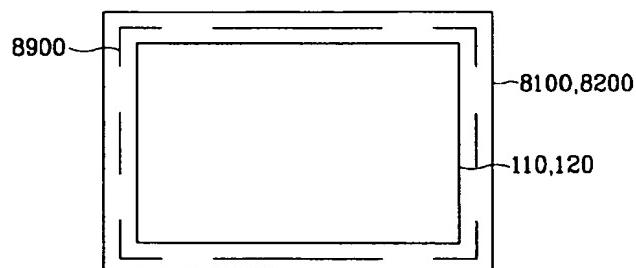
【図13a】



【図13d】



【図13f】



【手続補正書】

【提出日】平成13年6月4日(2001.6.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】図面の簡単な説明

【補正方法】変更

【補正内容】

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例によるインラインシステムを用いて完成した液晶表示装置用液晶パネルの構造を示した平面図。

【図2】図1のII-II'線に沿って切断した断面図。

【図3】本発明の実施例による液晶表示装置を製造するためのインラインシステムを示す構成図。

【図4a】スペーサを示した図面(その1)。

【図4b】スペーサを示した図面(その2)。

【図5a】封印材の形態を示した平面図(その1)。

【図5b】封印材の形態を示した平面図(その2)。

【図6a】封印材を硬化する順序を順次に示した断面図(その1)。

【図6b】封印材を硬化する順序を順次に示した断面図(その2)。

【図6c】封印材を硬化する順序を順次に示した断面図(その3)。

【図7a】液晶物質を塗布する工程を示した図面(その1)。

【図7b】液晶物質を塗布する工程を示した図面(その2)。

【図8a】圧力プレートに基板を吸着する方法を示した図面(その1)。

【図8b】圧力プレートに基板を吸着する方法を示した図面(その2)。

【図8c】圧力プレートに基板を吸着する方法を示した図面(その3)。

【図9a】平面吸着方法により基板を圧力プレートに吸着する方法を示した図面(その1)。

【図9b】平面吸着方法により基板を圧力プレートに吸着する方法を示した図面(その2)。

【図10】基板結合装置の構造について具体的に示した構成図(その1)。

【図11】基板結合装置の構造について具体的に示した構成図(その2)。

【図12】基板結合装置の構造について具体的に示した構成図(その3)。

【図13a】基板結合装置の圧縮プレートの構造を示した平面図。

【図13b】基板結合装置の圧縮プレートの構造を示した平面図。

【図13c】基板結合装置の圧縮プレートの構造を示した平面図。

【図13d】基板結合装置の圧縮プレートの構造を示した平面図。

【図13e】基板結合装置の圧縮プレートの構造を示した平面図。

【図13f】基板結合装置の圧縮プレートの構造を示した平面図。

【図14】本発明の他の実施例による多数の基板結合装置を有する液晶表示装置用インラインシステムを示した構成図。

【符号の説明】

100 液晶パネル

110、120 絶縁基板

111、121、131、141 液晶セル領域

112、122 基板の中央部

130 液晶物質層

132 液晶物質

140 スペーサ

142 接着剤

150 封印材

1000 第1基板積載装置

2000 スペーサ噴射装置

3000 封印材塗布装置
 4000 封印材熱処理装置
 5000 液晶塗布装置
 5100 液晶塗布機
 6000 基板装着装置
 7000 第2基板積載装置

8000 基板結合装置
 8050 露光装置
 9000 アンロード装置
 1110、1120、1130、1140、1150、
 1170、1180 インライン移送装置

【手続補正書】**【提出日】**平成13年6月6日(2001.6.6)**【手続補正1】****【補正対象書類名】**明細書**【補正対象項目名】**図面の簡単な説明**【補正方法】**変更**【補正内容】****【図面の簡単な説明】****【図1】**本発明の実施例によるインラインシステムを用いて完成した液晶表示装置用液晶パネルの構造を示した平面図。**【図2】**図1のII-II'線に沿って切断した断面図。**【図3】**本発明の実施例による液晶表示装置を製造するためのインラインシステムを示す構成図。**【図4 a】**スペーサを示した図面(その1)。**【図4 b】**スペーサを示した図面(その2)。**【図5 a】**封印材の形態を示した平面図(その1)。**【図5 b】**封印材の形態を示した平面図(その2)。**【図6 a】**封印材を硬化する順序を順次に示した断面図(その1)。**【図6 b】**封印材を硬化する順序を順次に示した断面図(その2)。**【図6 c】**封印材を硬化する順序を順次に示した断面図(その3)。**【図7 a】**液晶物質を塗布する工程を示した図面(その1)。**【図7 b】**液晶物質を塗布する工程を示した図面(その2)。**【図8 a】**点吸着方法により基板を圧力プレートに吸着する方法を示した図面(その1)。**【図8 b】**点吸着方法により基板を圧力プレートに吸着する方法を示した図面(その2)。**【図8 c】**点吸着方法により基板を圧力プレートに吸着する方法を示した図面(その3)。**【図9 a】**平面吸着方法により基板を圧力プレートに吸着する方法を示した図面(その1)。**【図9 b】**平面吸着方法により基板を圧力プレートに吸着する方法を示した図面(その2)。**【図10】**基板結合装置の構造について具体的に示した構成図(その1)。**【図11】**基板結合装置の構造について具体的に示した構成図(その2)。**【図12】**基板結合装置の構造について具体的に示した構成図(その3)。**【図13 a】**基板結合装置の圧縮プレートの構造を示した平面図。**【図13 b】**基板結合装置の圧縮プレートの構造を示した平面図。**【図13 c】**基板結合装置の圧縮プレートの構造を示した平面図。**【図13 d】**基板結合装置の圧縮プレートの構造を示した平面図。**【図13 e】**基板結合装置の圧縮プレートの構造を示した平面図。**【図13 f】**基板結合装置の圧縮プレートの構造を示した平面図。**【図14】**本発明の他の実施例による多数の基板結合装置を有する液晶表示装置用インラインシステムを示した構成図。**【符号の説明】**

100 液晶パネル

110、120 絶縁基板

111、121、131、141 液晶セル領域

112、122 基板の中央部

130 液晶物質層

132 液晶物質

140 スペーサ

142 接着剤

150 封印材

1000 第1基板積載装置

2000 スペーサ噴射装置

3000 封印材塗布装置

4000 封印材熱処理装置

5000 液晶塗布装置

5100 液晶塗布機

6000 基板装着装置

7000 第2基板積載装置

8000 基板結合装置

8050 露光装置

9000 アンロード装置

1110、1120、1130、1140、1150、

1170、1180 インライン移送装置

フロントページの続き

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マコト(参考)
G 0 2 F	1/1339	5 0 0	5 0 0
		5 0 5	4 F 0 4 2
	1/1341		5 0 5
		1/1341	

F ターム(参考) 2H088 EA02 FA02 FA03 FA04 FA09
FA30 MA20
2H089 LA46 NA09 NA22 NA32 NA39
NA44 NA56 NA60 PA16 QA12
4D075 AC08 AC09 AC19 AC64 AC73
AE02 AE03 BB26Z BB42Z
BB46Z BB56Z CA47 DA06
DA34 DA35 DC24 EA01 EA19
EA21
4F040 AA02 AA20 AA33 AB01 AC01
AC08 BA04 CA15 DB12 DB16
4F041 AA02 AA05 AB02 BA05 BA13
BA22
4F042 AA02 AA10 DB01 DB41 ED02
ED04 ED05